

MonoBis® 京都モノテック

MonoBis® は新規シリカ多孔体（※）を用いた一体型（モノリス）シリカカラムです。μm サイズのマクロ孔と nm サイズのメソ孔の 2 種類の細孔を有しており、通常のカラムのように粒子を充てんするのではなく、棒状のモノリス型でカラムを作製しております。

●低いカラム負荷圧

モノリス型カラムは貫通したマクロ孔により、粒子充てんカラムの 1/5 ~ 1/10 と非常に負荷圧を低くできます。

●小さな流速依存性

モノリス型カラムはシリカ骨格径が 1μm 程度と小さいため、移動相の流速依存性が非常に小さくなり、高流量（短時間分離）でも高い分離能を維持します。

●高分子試料の高速分離

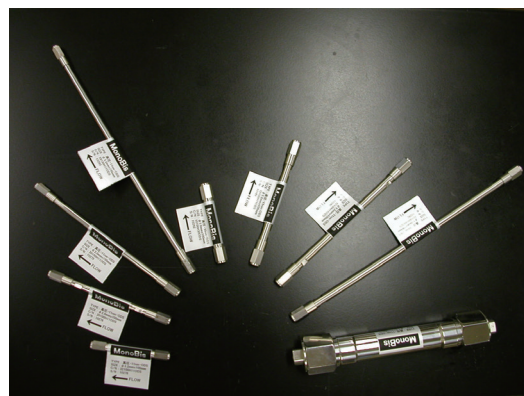
メソポア径 30nm のワイドポアタイプも用意しております。タンパク質のような高分子量試料の高速分析には最適なカラムとなっております。

●高圧タイプと低圧タイプ

高圧タイプと低圧タイプの 2 種類をご用意しております。

●超高純度シリカ

シリカモノリスはゾルゲル法により作製しており、原料の段階から超高純度を実現しております。



直径 1.0 ~ 18mm、長さ 50 ~ 250mm と
いろいろなサイズをご用意しております。

※:新規シリカ多孔体は、国立大学法人京都大学 曾我 直弘先生、中西和樹先生により発明、開発されました。この技術を用いて“MonoBis®”は京都モノテックで開発し生産されています。

長さ (mm)	内径 (mm)	圧	メソポア径	表面修飾	P/N	希望小売価格 (税抜/円)	長さ (mm)	内径 (mm)	圧	メソポア径	表面修飾	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
150	3.2	高圧	11nm	ODS・エンドキャップ	32150H110DS	80,000	150	1.0	高圧	11nm	ODS・エンドキャップ	10150H110DS	95,000
150	3.2			Si	32150H11SI	70,000	150	1.0			Si	10150H11SI	85,000
150	3.2		30nm	ODS・エンドキャップ	32150H300DS	95,000	150	1.0		30nm	ODS・エンドキャップ	10150H300DS	110,000
150	3.2			Si	32150H30SI	85,000	150	1.0			Si	10150H30SI	100,000
150	3.2	低圧	11nm	ODS・エンドキャップ	32150L110DS	80,000	150	1.0	低圧	11nm	ODS・エンドキャップ	10150L110DS	95,000
150	3.2			Si	32150L11SI	70,000	150	1.0			Si	10150L11SI	85,000
150	3.2		30nm	ODS・エンドキャップ	32150L300DS	95,000	150	1.0		30nm	ODS・エンドキャップ	10150L300DS	110,000
150	3.2			Si	32150L30SI	85,000	150	1.0			Si	10150L30SI	100,000
100	3.2	高圧	11nm	ODS・エンドキャップ	32100H110DS	70,000	100	1.0	高圧	11nm	ODS・エンドキャップ	10100H110DS	90,000
100	3.2			Si	32100H11SI	60,000	100	1.0			Si	10100H11SI	80,000
100	3.2		30nm	ODS・エンドキャップ	32100H300DS	85,000	100	1.0		30nm	ODS・エンドキャップ	10100H300DS	105,000
100	3.2			Si	32100H30SI	75,000	100	1.0			Si	10100H30SI	95,000
100	3.2	低圧	11nm	ODS・エンドキャップ	32100L110DS	70,000	100	1.0	低圧	11nm	ODS・エンドキャップ	10100L110DS	90,000
100	3.2			Si	32100L11SI	60,000	100	1.0			Si	10100L11SI	80,000
100	3.2		30nm	ODS・エンドキャップ	32100L300DS	85,000	100	1.0		30nm	ODS・エンドキャップ	10100L300DS	105,000
100	3.2			Si	32100L30SI	75,000	100	1.0			Si	10100L30SI	95,000
50	3.2	高圧	11nm	ODS・エンドキャップ	3250H110DS	60,000	50	1.0	高圧	11nm	ODS・エンドキャップ	1050H110DS	85,000
50	3.2			Si	3250H11SI	55,000	50	1.0			Si	1050H11SI	80,000
50	3.2		30nm	ODS・エンドキャップ	3250H300DS	70,000	50	1.0		30nm	ODS・エンドキャップ	1050H300DS	100,000
50	3.2			Si	3250H30SI	65,000	50	1.0			Si	1050H30SI	90,000
50	3.2	低圧	11nm	ODS・エンドキャップ	3250L110DS	60,000	50	1.0	低圧	11nm	ODS・エンドキャップ	1050L110DS	85,000
50	3.2			Si	3250L11SI	55,000	50	1.0			Si	1050L11SI	80,000
50	3.2		30nm	ODS・エンドキャップ	3250L300DS	70,000	50	1.0		30nm	ODS・エンドキャップ	1050L300DS	100,000
50	3.2			Si	3250L30SI	65,000	50	1.0			Si	1050L30SI	90,000
150	2.0	高圧	11nm	ODS・エンドキャップ	20150H110DS	80,000			高圧	11nm	ODS・エンドキャップ		
150	2.0			Si	20150H11SI	70,000					Si		
150	2.0		30nm	ODS・エンドキャップ	20150H300DS	95,000				30nm	ODS・エンドキャップ		
150	2.0			Si	20150H30SI	85,000					Si		
100	2.0	高圧	11nm	ODS・エンドキャップ	20100H110DS	70,000			高圧	11nm	ODS・エンドキャップ		
100	2.0			Si	20100H11SI	60,000					Si		
100	2.0		30nm	ODS・エンドキャップ	20100H300DS	85,000				30nm	ODS・エンドキャップ		
100	2.0			Si	20100H30SI	75,000					Si		
50	2.0	高圧	11nm	ODS・エンドキャップ	2050H110DS	60,000			高圧	11nm	ODS・エンドキャップ		
50	2.0			Si	2050H11SI	55,000					Si		
50	2.0		30nm	ODS・エンドキャップ	2050H300DS	70,000				30nm	ODS・エンドキャップ		
50	2.0			Si	2050H30SI	65,000					Si		

組み合わせにより様々な製品をお選びいただけます。
上記以外の仕様も御相談により承ります。